

公司沿革：

年月	重要紀事
民國94年9月	公司登記成立於台北市，實收資本額新台幣100萬元。
民國94年12月	申請獲准進入新竹科學工業園區，公司正式成立。聯笙電子以技術股4,000萬元做價，現金增資7,900萬元，實收資本額新台幣1億2,000萬元。
民國95年3月	發表世界上第一款以CMOS研製之衛星用4X2矩陣晶片A7531。
民國95年3月	2.4GHz晶片A7122成功打入Gaming手柄PS3市場。
民國95年4月	2.4GHz晶片A7121成功打入世界第一款Digital Video Baby monitor市場。
民國95年11月	2.4GHz晶片A7122成功打入Gaming Rock Band市場。
民國97年1月	衛星接收器晶片A7282成功打入PND市場。
民國97年6月	2.4GHz系列晶片成功打入無線航模市場。
民國97年9月	取得ISO 9001：2008品質認證。
民國97年11月	sub_1GHz系列晶片成功打入電力節能市場。
民國97年12月	2.4GHz系列晶片成功打入電腦周邊市場。
民國99年3月	sub_1GHz系列晶片成功打入汽車市場。
民國99年3月	2.4GHz系列晶片成功打入體感遊戲市場。
民國99年3月	笙科電子大陸深圳代表處正式成立。
民國99年3月	曾三田先生當選為笙科電子董事長。
民國99年5月	溢價增資，增資後實收資本額為新台幣2億3,382萬元。
民國99年8月	遷址至新竹科學工業園區力行一路一號一樓矽導研發中心。
民國99年9月	sub_1GHz系列晶片成功打入無線抄表市場。
民國99年11月	2.4GHz系列晶片成功打入物聯網市場。
民國100年6月	盈餘轉增資，增資後實收資本額為新台幣3億3,539萬元。
民國100年7月	整合Tone Detector衛星用2X2矩陣晶片A7522成功打入日本市場。
民國100年8月	2.4GHz標準型Zigbee晶片成功打入物聯網市場。
民國100年9月	溢價增資，增資後實收資本額為新台幣3億9,539萬元。
民國100年12月	笙科電子大陸上海代表處正式成立。
民國100年12月	經行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准股票補辦公開發行。
民國101年2月	2.4GHz晶片A7153獲得Zigbee聯盟Zigbee/Rf4CE認證。
民國101年2月	sub_1GHz晶片A7108成功打入無線智能電表市場，並獲得2012 China ACE Award年度最佳射頻/無線產品獎。
民國101年4月	成立薪資報酬委員會。
民國101年5月	發表新一代2.4GHz高整合型的射頻收發器晶片A7137。
民國101年5月	員工紅利轉增資及員工認股權憑證增資，增資後實收資本額為新台幣4億934萬元。
民國101年6月	登錄興櫃股票。
民國102年1月	發表第五代Single LNB衛星接收器晶片A7833。
民國102年1月	發表第五代4x1 DiSEqC LNB Switch A7511。
民國102年2月	發表第四代內建可達20dBm PA 4Mbps高速2.4GHz TRx A7190。
民國102年2月	發表第五代4mA低接收電流sub_1GHz TRx A7129/A7139。
民國102年5月	上櫃股票掛牌。
民國102年6月	上櫃前現金增資，增資後實收資本額為新台幣4億5,480萬元。
民國103年2月	藍牙低功耗系列晶片獲Bluetooth QBB認證，並發表臺灣第一顆藍牙低功耗晶片。
民國103年3月	發表一系列的新一代高整合RF SoC，如無線聲音傳輸A8101，藍牙低功耗A8105，sub_1GHz SoC A9108，加深物聯網的布局。
民國103年8月	發表新一代高整合Zigbee/Rf4CE無線射頻收發SoC晶片A8153。
民國103年8月	發表S-band Down Converter衛星接收晶片A7837。

民國103年8月	發表新一代高整合sub_1GHz無線RF SoC晶片 A9112。
民國103年8月	發表新一代高整合sub_1GHz無線晶片A7112。
民國103年8月	發表2.4GHz 2Mbps無線收發SoC晶片 A8125。
民國103年8月	發表2.4GHz 10dBm 2Mbps無線收發SoC晶片 A8137。
民國103年9月	發表2.4GHz 500Kbps無線收發SoC晶片 A8106。
民國104年2月	發表2.4GHz單向2Mbps無線發射SoC晶片A8325。
民國104年3月	發表2.4GHz 無線收發 USB SoC晶片A8108。
民國104年4月	發表藍牙低功耗(Bluetooth LE)無線收發SoC晶片A8107。
民國104年4月	發表低接收電流 sub_1GHz 無線 RF SoC A9129/A9139。
民國104年6月	盈餘轉增資，增資後實收資本額為新台幣5億1,045萬元。
民國104年8月	推出內建19.5dBm PA高速 6Mbps 2.4GHz FSK 無線射頻收發晶片A7196。
民國104年8月	發表藍牙低功耗(Bluetooth LE) SiP晶片A8107 SiP。
民國104年8月	發表2.4GHz 無線遙控玩具車 RF IC A7216/A7316。
民國104年8月	發表高整合 2.4GHz無線語音SoC晶片A8100。
民國104年8月	發行限制員工權利新股，發行後實收資本額為新台幣5億2,045萬元。
民國104年9月	發表新一代 整合型高精確度ADC 無線sub_1GHz RF SoC A9109。
民國104年9月	推出新一代4x4 整合型LNB SWITCH 晶片A7544。
民國104年11月	發表LCD 顯示無線 SoC 系列 A8525/A8526。
民國105年1月	發表5.8GHz新產品線無線射頻收發晶片A5130。
民國105年1月	推出sub_1GHz DSSS展頻無線收發晶片A7159。
民國105年1月	溢價增資，增資後實收資本額為新台幣5億8,019萬元。
民國105年3月	A8107 SiP獲得2016年度大中華IC設計成就獎。
民國105年8月	發表5.8GHz新產品無線射頻收發晶片A5125。
民國105年8月	推出新一代2x4整合型LNB SWITCH晶片A7524。
民國105年9月	發表新一代內建ARM® Cortex®-M0藍牙低功耗(Bluetooth LE) SoC晶片A8107M0。
民國105年10月	發表新一代高整合sub_1GHz無線語音SoC系列晶片A9101。
民國105年10月	發表新一代高整合2.4GHz無線音頻SoC晶片A8102。
民國105年12月	發表DSSS展頻調變sub_1GHz 無線 RF SoC晶片A9159。
民國106年3月	發表具LCD顯示功能BLE晶片系列A8507/A8508。
民國106年3月	發表具LCD顯示功能sub_1GHz A9508。
民國106年3月	推出新一代高隔離4x2 LNB SWITCH 晶片A7540/A7539。
民國106年3月	5.8GHz無線晶片A5130/A5125獲得2017年度大中華IC設計公司成就獎：年度最佳RF無線IC。
民國106年6月	發表新一代13dBm 2.4GHz 2Mbps 無線收發SoC 芯片 A8137M0。
民國106年9月	遷址至新竹縣竹北市台元科技園區。
民國107年3月	發表藍牙低功耗(Bluetooth LE) SoC晶片 A8115。
民國107年5月	發表藍牙低功耗(Bluetooth LE) Mesh /BLE Central SoC晶片 A3107M0。
民國107年5月	發表新一代高整合藍牙低功耗(Bluetooth LE) SoC系列晶片 A3113,A3512與A3513。
民國108年1月	發表藍牙低功耗(Bluetooth LE) Mesh/BLE Central SoC晶片 A3117M0。
民國108年1月	發表5.8GHz無線收發 SoC晶片 A1011。
民國108年1月	發表2.4GHz無線收發 SoC晶片 A8125M0。

民國108年1月	發表新一代sub_1GHz無線收發晶片 A7136。
民國108年8月	發表新一代sub_1GHz無線收發晶片 A7169。
民國108年9月	發表新一代5.8GHz無線射頻收發晶片 A5133。
民國109年3月	發表sub_1GHzDSSS展頻無線收發晶片A7119。
民國109年6月	發表sub_1GHz無線單向接收晶片 A7209/A7229。
民國109年6月	推出具DSSS展頻功能2.4GHz無線收發晶片A7157。
民國109年6月	成立審計委員會。
民國110年7月	發表sub_1GHz無線發射SoC晶片 A9339。
民國110年12月	2.4GHz無線收發晶片A7157獲得2021年度EDN亞洲金選獎:年度最具潛力RF無線IC。
民國111年3月	發表2.4GHz無線收發SoC晶片 A8131M0。
民國111年3月	發表低接收電流sub_1GHz無線收發 SoC晶片 A9129F6/A9139F6/A9159F6。
民國111年12月	2.4GHz無線收發SoC晶片A8131M0獲得2022年度EDN亞洲金選獎:年度最佳RF無線IC。
民國112年10月	發表sub_1GHz低接收電流無線收發 SOC晶片 A9129M0。
民國112年11月	發表1.65mA超低接收電流sub_1GHz無線收發晶片 A7149。
民國112年12月	Sub_1GHz 無線收發晶片A7149獲得2023年度EDN亞洲金選獎:年度最佳RF無線IC。
民國113年1月	A7136 sub_1GHz射頻晶片成功通過WiSUN協會驗證並獲得WiSUN FAN 1.0認證。
民國113年3月	A9146M4(SoC)通過WiSUN FAN 1.0認證，提供極致性能，奠定開發的效能基石。
民國113年5月	笙科電子亮相WIRELESS JAPAN x WTP展，最新低功耗射頻晶片與 Wi-SUN 技術吸引眾多業者關注。
民國113年7月	A9146M4成功通過Wi-SUN FAN v1.0 (Router)及(Border Router) 認證。
民國113年8月	笙科電子(AMICCOM) 將於2024年IOTE國際物聯網展深圳站亮相，展示最新無線技術。
民國113年10月	笙科發佈Sub-1GHz無線收發 SOC晶片 A9139M0。
民國113年10月	笙科電子將於2024.10.30~2024.11.1參加AloT Korea Exhibition，展示其在無線通訊技術領域的最新研發成果。
民國113年11月	笙科電子即將亮相第二十六屆深圳高交會，展示最新RF技術與最有效率的無線通信方案！
民國113年11月	笙科電子發表新一代低接收電流Sub1GHz無線SoC晶片A9136M4，全面支援Wi-SUN協議。
民國113年12月	笙科電子 A9136M4 榮獲 2024 EE Awards亞洲金選獎-年度最佳RF/Wireless IC - 「Most Promising Product」。
民國114年1月	笙科發佈2.4GHz無線收發 SOC晶片 A8106M0。
民國114年3月	笙科電子AMICCOM亮相 Embedded World 2025，展現無線射頻技術創新實力。
民國114年11月	笙科發佈2.4GHz無線收發語音SOC晶片 A8103。
民國114年11月	笙科電子將於2025.11.26~2025.11.28參加AloT Korea Exhibition，展示其無線通訊技術領域最新研發成果。